

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
19. Mai 2005 (19.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/045926 A2**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01L 23/31**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/002374

(22) Internationales Anmeldedatum:  
25. Oktober 2004 (25.10.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
103 50 239.4 27. Oktober 2003 (27.10.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-  
Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HETZEL, Wolf-  
gang [DE/DE]; Schanzenweg 14, 89564 Nattheim (DE).  
THOMAS, Jochen [DE/DE]; Ottilienstr. 46 A, 81827  
München (DE).

(74) Anwalt: SCHWEIGER, Martin; c/o Kanzlei Schweiger  
& Partner, Karl-Theodor-Str. 69, 80803 München (DE).

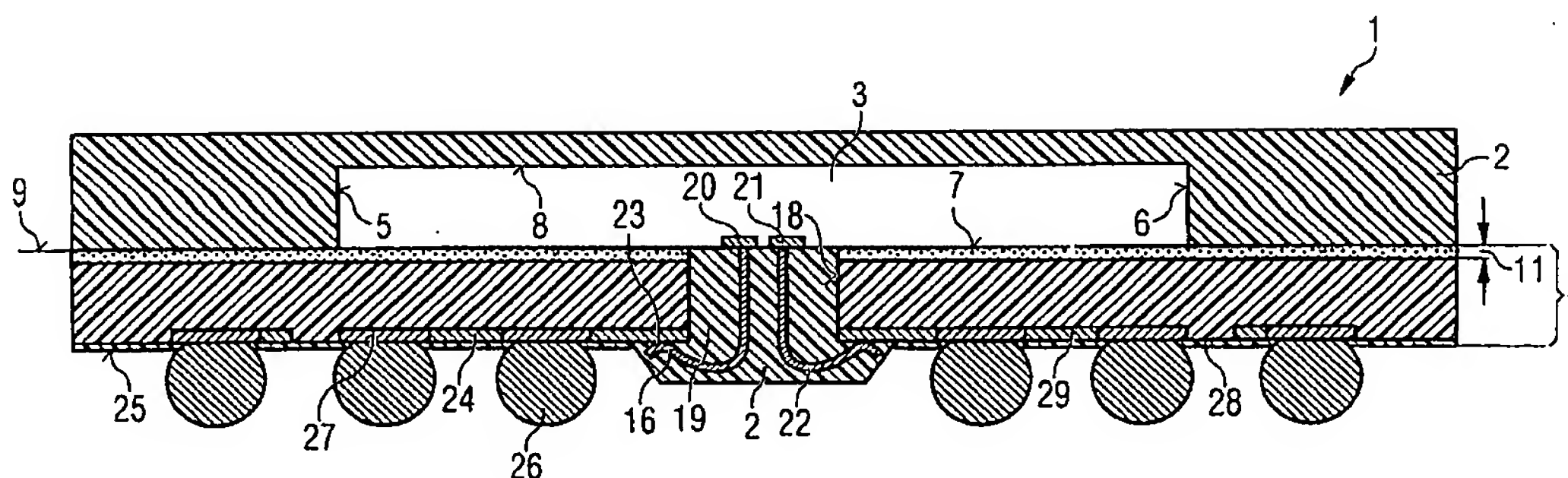
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,  
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,  
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,  
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,  
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,  
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,  
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,  
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,  
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,  
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SEMICONDUCTOR COMPONENT COMPRISING SYNTHETIC HOUSING MATERIAL, SEMICONDUCTOR  
CHIP AND CIRCUIT SUPPORT, AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) Bezeichnung: HALBLEITERBAUTEIL MIT GEHÄUSEKUNSTSTOFFMASSE, HALBLEITERCHIP UND SCHAL-  
TUNGSTRÄGER SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DESSELBEN



(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor component (1) comprising a synthetic housing material (2), a semiconductor chip (3) and a circuit support (4). The semiconductor chip (3) is embedded in the synthetic housing material (2). The top surface of the semiconductor chip (3) and the synthetic housing material (2) are disposed on a circuit support (4). An elastic adhesive layer (11) is interposed between the circuit support (4) and the synthetic housing material (2) comprising the semiconductor chip (3), thereby mechanically decoupling an upper area from a lower area of the semiconductor component (1).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauteil (1) mit Gehäusekunststoffmasse (2), einem Halbleiterchip (3) und mit einem Schaltungsträger (4). Der Halbleiterchip (3) ist in eine Gehäusekunststoffmasse (2) eingebettet. Die Oberseite des Halbleiterchips (3) und die Gehäusekunststoffmasse (2) sind auf einem Schaltungsträger (4) angeordnet. Zwischen dem Schaltungsträger (4) und der Gehäusekunststoffmasse (2) mit dem Halbleiterchip (3) ist eine elastische Klebstofflage (11) zur mechanischen Entkopplung eines oberen Bereichs von einem unteren Bereich des Halbleiterbauteils (1) angeordnet.

WO 2005/045926 A2



**Veröffentlicht:**

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*